

群聯電子

部門	實習職缺名稱	安排實習內容、題目	人數	備註(暑期、長期、長期部分工時)
研發二部(3)	韌體工程師	韌體程式的開發與編譯 / 自動化程式開發與編譯	8	長期部分工時
功能架構研發一部	韌體工程師	1.protocol tool 撰寫 2.分析軟體撰寫 3.基本 SSD 常識 4.SEC tool 分析 5.Host Benchmark 分析	3	暑期
研發五部(2)	韌體工程師	1. SSD 韌體相關知識訓練 2. 測試軟體分析與效能優化 3. SSD 韌體功能正確性驗證 4. 自動化分析程式撰寫	3~5	長期部分工時
數位設計一部	數位 IC 工程師	1. assertion check 2. PMA ctrl module simulation.	2	暑期
設計支援部	CAD 工程師	類比 CAD 設計流程開發與應用 1. 前段 SPICE Model 測試驗證流程、EM/IR 模擬流程 2. PDK 認識與設計支援 3. 後段 Signoff、RC Extraction 流程	2	暑期